

プラスチック成形加工学会 第116回 講演会

プラスチック微細接合技術最新動向と今後の展望

—微細接合の現状と今後—

自動車部品や、半導体部品、光学部品などが複雑化していく中で、単一の成形では高機能な複合成形品が得られなくなっており、接合技術の重要性が一段と増してきております。今後日本が国際競争力を高めて行くに当たり、付加価値の高い複雑な成形品を作製する異種接合を向上させていくことは極めて重要であると考えております。そこで本講演会では接合部における応力や、歪みに対して高度な制御が要求される微細接合技術に焦点を当て、その基礎的な考え方から応用まで最新の接合技術を紹介し、今後の課題や発展について提供する講演会を企画いたしました。

[企画担当委員:山田岳大 (埼玉県産業技術総合センター), 町田邦郎 (ブリヂストン), 棕田宗明 (三菱電機), 富永洋一 (東京農工大)]

1. 開催日 : 2010年3月2日 (火)
2. 場所 : 工学院大学 新宿キャンパス
高層棟 28F 第1・2会議室
住所 : 新宿区西新宿1-24-2
TEL : TEL 03-3342-1211(代表)
行き方 : JR「新宿駅」下車、西口より徒歩 5 分
<http://www.kogakuin.ac.jp/map/shinjuku/index.html>
3. 主催 : プラスチック成形加工学会
4. 協賛 (予定) : 高分子学会, 日本化学会, 化学工学会, S P E 日本支部, 日本機械学会, 精密工学会,

日本レオロジー学会, 日本塑性加工学会, 日本材料学会, 日本複合材料学会, マテリアルライフ学会, 型技術協会, 強化プラスチック協会, 日本合成樹脂技術協会, 日本ゴム協会, 日本プラスチック機械工業会, 繊維学会, 日本繊維機械学会, 自動車技術会, 複合材料界面科学研究会

5. 定員 : 100名 (先着順, 定員に達し次第締切)

6. 参加費 (税込み) :

会員・賛助会員 15,000円,
学生会員 1,000円,
協賛学協会員 25,000円,
非会員 30,000円,
学生非会員 3,000円

7. 申し込み・お問い合わせ先

申込用紙に必要事項記入の上, 学会事務局まで FAX または郵送にてお申し込みください。なお, 参加費は銀行振込, 郵便振替, もしくは現金書留でご送金ください。

(社)プラスチック成形加工学会 事務局
〒141-0032 東京都品川区大崎 5-8-5
グリーンプラザ五反田第2 205
TEL (03) 5436-3822 FAX (03) 3779-9698
郵便振替番号 00130-7-402104
銀行振込口座 : みずほ銀行 銀座中央支店 (125)
普通預金 1952925
名義 社団法人プラスチック成形加工学会

8. プログラム :

時刻	内容	講師
10:00—10:50	表面活性化プロセス融合による低温接合技術の確立とマイクロデバイスへの応用 キーワード : プラズマ、低温接合、マイクロチップ	早稲田大学 水野 潤
10:50—11:00	質疑応答・名刺交換	
11:00—11:50	トリアジンチオール接着技術による異種材料複合化の展開 キーワード : 分子接着、接着、異種材料、めっき	岩手大学 平原英俊
11:50—12:00	質疑応答・名刺交換	
12:00—13:00	昼休み	
13:00—13:50	レーザー樹脂溶着の微細接合への適用 キーワード : レーザ、微細、樹脂溶着	浜松ホトニクス(株) 松本 聡
13:50—14:00	質疑応答・名刺交換	
14:00—14:50	ナノコンポジット技術を用いた光通用マイクロレンズ用樹脂開発 キーワード : ナノコンポジット、マイクロレンズ、反射防止膜	オムロン(株) 福原智博
14:50—15:00	質疑応答・名刺交換	
15:00—15:50	MEMSの低応力実装・パッケージング技術 キーワード : MEMS、異種接合、残留応力、WLP	パナソニック 電工(株) 佐名川佳治
15:50—16:00	質疑応答・名刺交換	
16:00—16:50	高分子材料のナノ接合 キーワード : ガラス転移、拡散、表面・界面	九州大学 田中敬二
16:50—17:00	質疑応答・名刺交換	

